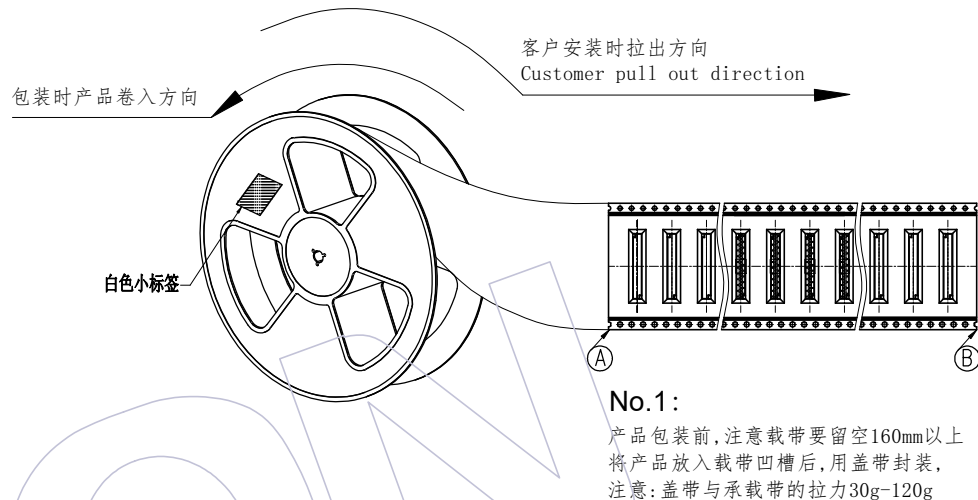
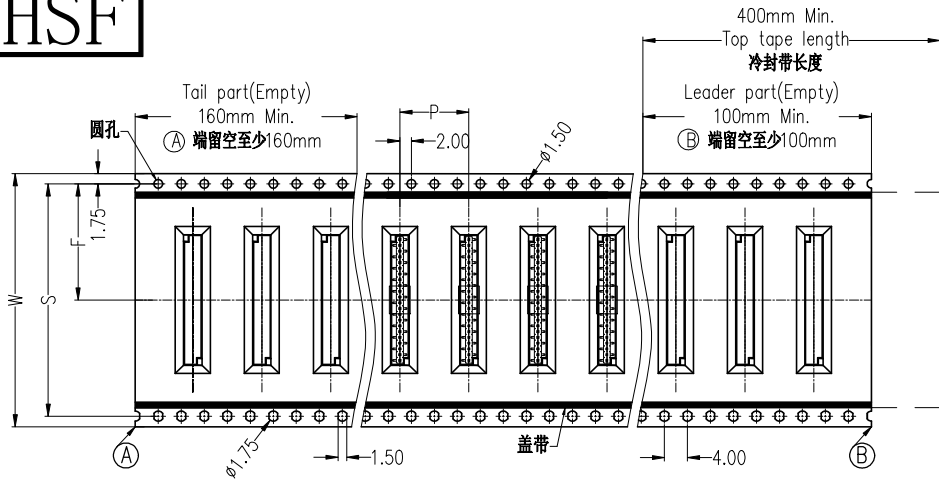


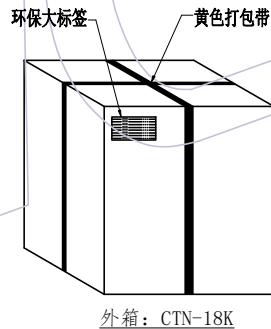
HSF



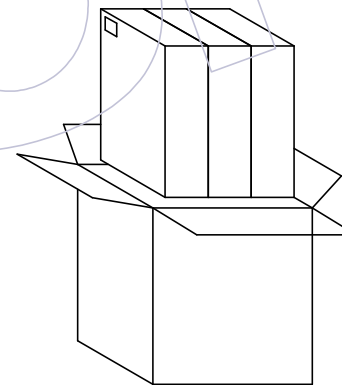
说明

1. 产品如图所示型态放入载带
2. 注意各标签样式、位置及方向的一致性；
3. 标签如客户有特殊要求，则按客户要求黏贴；
4. 打外箱包装带时需注意，打为十字型，另出国内客户，未打包装带。
5. 未尽事宜依据交货注意事项。

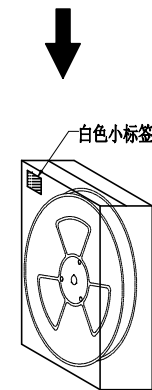
W	S	F	Reel/内箱	内箱/外箱
12.0±0.30	\	5.50±0.15	6	3
16.0±0.30	\	7.50±0.15	4	3
24.0±0.30	\	11.50±0.15	3	3
32.0±0.30	28.40±0.15	14.20±0.15	2	3
44.0±0.30	40.40±0.15	20.20±0.15	2	3
56.0±0.30	52.40±0.15	26.20±0.15	1	3
72.0±0.30	68.40±0.15	34.20±0.15	1	3
88.0±0.30	84.40±0.15	42.20±0.15	1	3
104.0±0.30	100.40±0.15	50.20±0.15	1	3



No.4:
封箱, 打包, 贴标签。



No.3:
将内箱装入外箱(3内箱/外箱)
注意统一标签方向



No.2:
将卷盘套上防水袋,
放入1包干燥剂,
真空机封口后装入内箱,
用封箱胶封装好, 并贴上标签。

变更
记录

版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE	工程图 ENGINEERING	绘图 DRAW	苏珊	2023/03/15	SCALE	FIT	WCON
A0	2023/03/15	NEW	-----	-----	X.X	±0.20	设计		UNIT	mm	WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO., LTD
					X.XX	±0.20	审核		SIZE	A4	料号 PART NO.
					X.XXX	±0.10	检查		SHEET	1/1	WF2002-WMXXXXWR1
					Angle	± 2'	核准		PROJ.	品名 TITLE:	2.00mm Wafer, SMT包装规范
					DIM	TOL	核准				